**2014’中国溶胶-凝胶学术研讨会暨国际论坛**

**第一轮会议通知**

中国溶胶凝胶学术研讨会暨国际论坛（简称研讨会）是由中国硅酸盐学会溶胶凝胶分会（以下简称分会）主办的一项学术会议，是我国从事与溶胶-凝胶科研人员进行学术交流的平台。从1990年举办首届会议后，会议的系列召开增进了我国溶胶凝胶及其相关学科研究学者间的了解与学术交流。根据2013年12月13日中国硅酸盐学会溶胶凝胶分会理事会讨论决定：2014’中国溶胶-凝胶学术研讨会暨国际论坛拟于2014年10月中旬在云南省昆明市举办，由昆明理工大学承办。

本次会议规模约150-200人，现在向全国范围内的学者及企业精英征集论文，欢迎投送论文稿件并到会交流。现在将有关会议的具体通知如下：

**一、会议主题**

**1、制备方法及原理**

溶胶-凝胶化学及其基础、溶液法、自组装法

2、基于溶胶-凝胶或其他溶液法制备的材料

气凝胶、薄膜、涂层及隔膜材料、微纳孔和超分子材料以及光、热、电、磁性生物、传感及环境等功能材料

3、应用

溶胶-凝胶技术的工业化应用

**二、重要时间**

1、  会议举办时间及地点：2014年10月17-20；昆明市学府路253号昆明理工大学伍集成会堂。

2、  会议投稿截止日期为2014年7月30日。

**三、会议论文全文要求**

1、论文全文将由《稀有金属材料与工程》（SCI）审查后公开出版。对论文全文稿的要求，详见《稀有金属材料与工程》的有关征稿规定。拟投全文的作者必须5月30日之前提供论文摘要、在7月30日之前提供论文全文。论文摘要评审时间约2-3个星期。

2、论文的全文稿要求，详见《稀有金属材料与工程》的有关征稿规定，论文的版面费（不含在注册费内）根据期刊相关规定执行。

3、论文文稿通过电子邮件方式发至会务组（邮箱：[894790950@qq.com](mailto:894790950@qq.com)、[14453718@qq.com](mailto:14453718@qq.com)电话13708453523/0871-65188856）。电子稿要求是Word格式录入（详见附件论文模版，来稿请注明“溶胶凝胶会议”字样）。

4、会议只录用经注册参会人员的论文，一个注册人只可以投一篇论文。

5、只接受没有在国内、外正式刊物和学术会议上发表过的论文详细摘要稿，相关知识产权问题请自行处理。

**四、会议组织：**

**主办单位：**中国硅酸盐学会溶胶凝胶分会

**承办单位：**昆明理工大学

**会议主席**：樊先平（浙江大学）

**会议执行主席：**邱建备（昆明理工大学）

**学术委员会主席：**杨辉（浙江大学）

**学术委员会成员：**

杨辉（浙江大学）

潘伟（清华大学）

沈军（同济大学）

谭抚（中国硅酸盐学会）

樊先平（浙江大学）

罗仲宽（深圳大学）

宋力昕（中科院上硅所）

邱建备（昆明理工大学）

朱满康（北京工业大学）

唐永兴（中科院上光所）

**组织委员会主席：**邱建备（昆明理工大学）

**组织委员会成员：**

杨正文（昆明理工大学）

朱满康（北京工业大学）

郭兴忠（浙江大学）

杨勇（昆明理工大学）

韩缙（昆明理工大学）

陈露（浙江大学）

尹兆益（昆明理工大学）

周大成（昆明理工大学）

董祥（昆明理工大学）

**五、会议注册：**

非学生代表：2000 RMB（不含住宿费）

学生代表： 1200 RMB（不含住宿费、需凭学生证件）

**六、会务组联系方式：**

**杨正文、韩缙**

单位：昆明理工大学材料学院

地址：昆明市学府路253号

电话：13708453523、18214586370、0871-65188856

Mail：[894790950@qq.com](mailto:894790950@qq.com)、[85951846@qq.com](mailto:85951846@qq.com)

**热忱欢迎企业赞助本次会议，有意者请与会务组杨正文老师联系。**